

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON  
SYSTECH**

## **SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

### **晶門半導體有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

### **授出購股權**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而刊發。

晶門半導體有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於2021年12月8日收市後，根據本公司股東於2013年5月28日通過的一項決議案後所採納的本公司股份認購權計劃(「2013年購股權計劃」)，向本集團41名僱員(「承授人」)要約(惟須待彼等各自接納，方可作實)授出股份認購權(「購股權」)，以認購合共**18,000,000**股本公司股本中每股面值0.10港元的普通股。

有關授出購股權的詳情如下：

- |   |  |
|---|--|
| 授出日期  | ： 2021年12月8日(「授出日期」)                             |
| 所授出的購股權數目                                     | ： 18,000,000份購股權，每份賦予持有人認購1股本公司股本中每股面值0.10港元的普通股 |
| 所授出的購股權行使價                                    | ： 0.790港元，即下列的最高者：                               |
| (i) 本公司股份於授出日期的收市價                            | ： 0.790港元  |
| (ii) 緊接授出日期前五個營業日<br>在聯交所公佈的每日報價表<br>所載的平均收市價 | ： 0.776港元  |

**行使期：**

承授人收取的相關要約函件中列明若干條件及表現目標，倘相關承授人達成相關條件及表現目標，購股權將分成兩個批次供承授人行使，具體如下：

- (a) 第一批次(涉及所授出購股權數目的40%)可於2022年6月8日至2024年6月7日(首尾兩日包括在內)行使；及
- (b) 第二批次(涉及所授出購股權數目的60%)可於2023年6月8日至2025年6月6日(首尾兩日包括在內)行使。

誠如上文所披露，購股權的有效期為授出日期起至其相應的行使期屆滿為止。

倘相關條件及表現目標未能達成，相關的承授人將不獲歸屬任何購股權，所授出的相關購股權將告失效。

概無承授人為本公司董事、行政總裁或主要股東或彼等各自的任何聯繫人(按上市規則定義)。

承董事會命  
晶門半導體有限公司  
行政總裁  
王華志

香港，2021年12月8日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。